

Phase 1:  
Préparation PCBs  
Automatisation des mesures et  
relevés pour valider qualité  
assemblage

Phase 2:  
TESTS pâte à braser  
INVENTEK

Définition des types de taille  
et type et masse et pads des  
composants à tester vs pâte  
à braser (R,L,C, QFN, BGA,...)

Schématique pour donner  
vie électrique

Routage  
=> Simple face  
=> Double face

=>Quels substrats?  
=> Quelle(s) finition(s)?

Fabrication PCBs  
Finition 1  
Finition 2

Fabrication écrans  
sérigraphie

Mise en place process sérigraphie DEK  
Mise en place relevés optiques et IR  
Mise en place tests électriques avec banc  
d'instrumentation

=>Quels critères de succès  
assemblage?

Câblage cartes (pick and place manuel)  
Tests avec pâte à braser du commerce fournies par  
industriels (et Cirimat petite quantité) et profils  
thermiques différents

Extraction de critères  
Validation méthodologie